

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、情况概述

为推进公司收购控股子公司深圳市深科达半导体科技有限公司（以下简称“深科达半导体”或“标的公司”）少数股东所持 40%股权项目的实施，公司拟以公司所持深科达半导体部分或全部股权作为质押，向银行申请不超过 9600 万元的并购贷款，该并购贷款的贷款额度、贷款利率、贷款期限以及贷款条件以银行批复为准，具体内容以签订的相关合同内容为准。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟质押标的基本情况

- 1、名称：深圳市深科达半导体科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、成立时间：2016 年 7 月 4 日
- 4、法定代表人：黄奕宏
- 5、注册资本：410.256 万元人民币
- 6、经营范围：一般经营项目是：软件的研发与销售；国内贸易，经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项

目), 许可经营项目是: 半导体行业智能化封装设备的技术开发、生产、测试与销售及技术服务。

7、最近一年一期主要财务数据

单位: 万元

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	25,861.70	29,681.07
2	负债总额	18,037.80	21,001.95
3	净资产	7,823.89	8,679.12
序号	项目	2023年1-12月	2024年1-9月
1	营业收入	17,081.43	14,461.81
2	净利润	483.83	1,211.23

注: 2023年财务数据为经会计师事务所审计金额, 2024年财务数据未经审计。

三、对公司的影响

本次质押子公司股权申请贷款的事项, 是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑, 有利于优化公司融资结构, 提高公司资金使用效率, 符合公司资金使用计划以及长远发展规划。目前公司经营状况良好, 具备较好的偿债能力, 本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险, 不会对公司的生产经营产生重大影响, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2024年10月29日